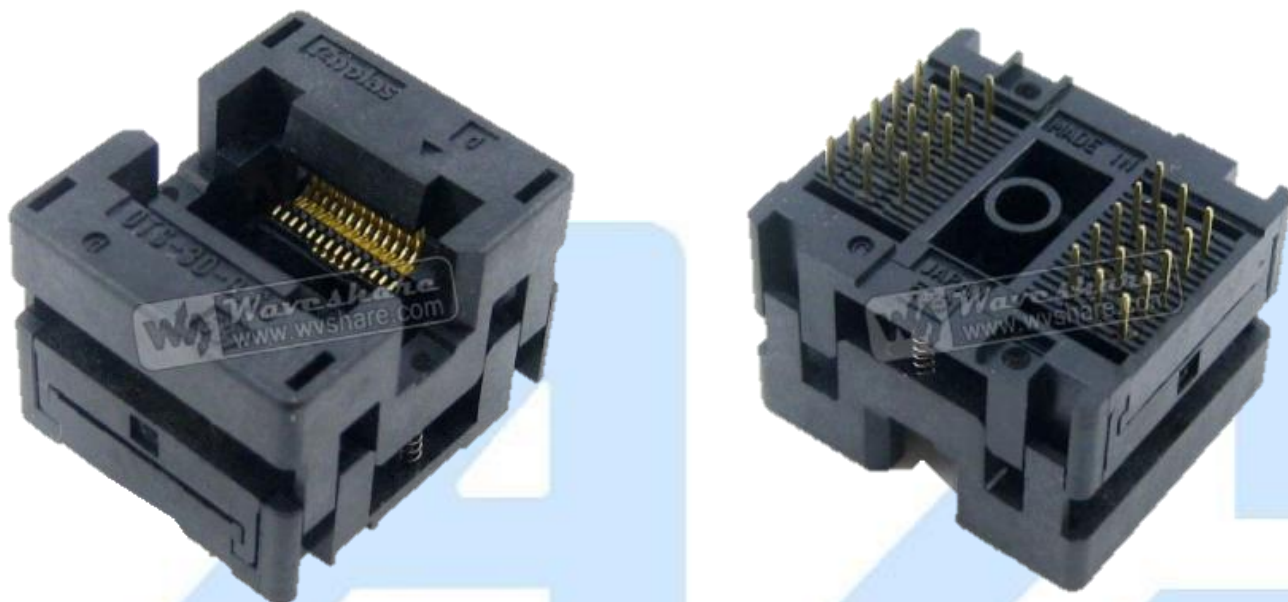


SKU3611: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO SSOP30, TSSOP30 A DIP 30 PINES



Descripción

Enplas IC & Burn-in Socket, para encapsulados: SSOP30, TSSOP30

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket OTS-30-0.65-01

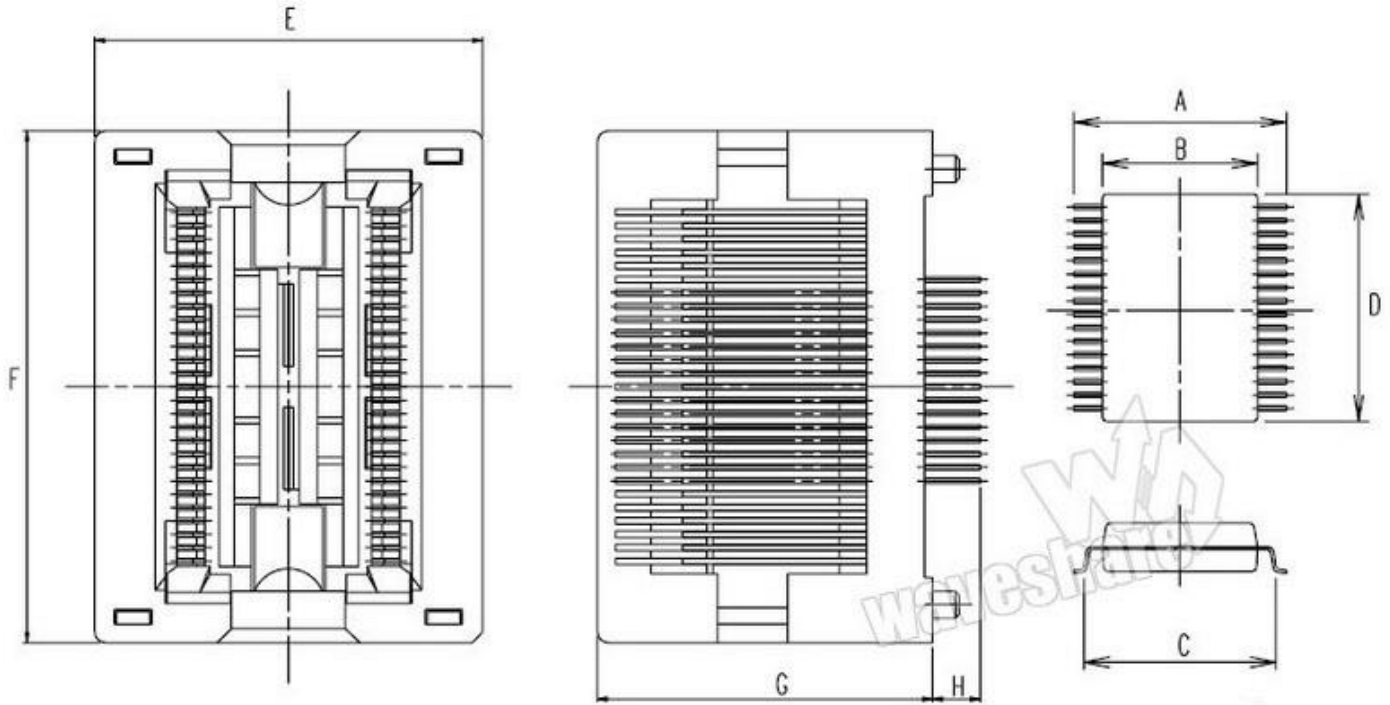
Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - SSOP30
 - TSSOP30
- Paso: 0.65 mm
- Ancho: 6.1 mm

Dimensiones

A=8.1 mm
B=6.1 mm
C=7.1 mm
D=9.9 mm

E=23 mm
F=20 mm
G=15.7 mm
H=2.8 mm



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO SSOP30, TSSOP30 A DIP 30 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 10/02/2021	No. Parte: SKU3611	
		REALIZO: MMS	REV: JFRR